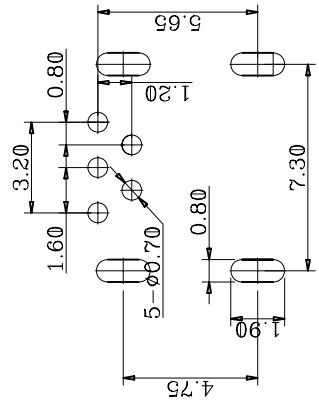
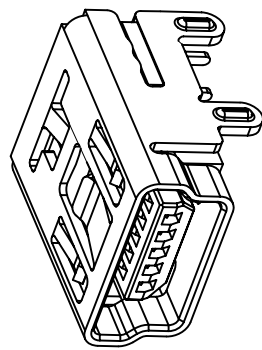
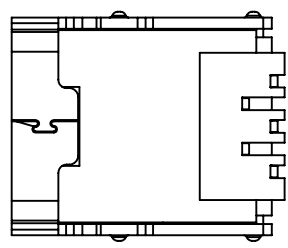
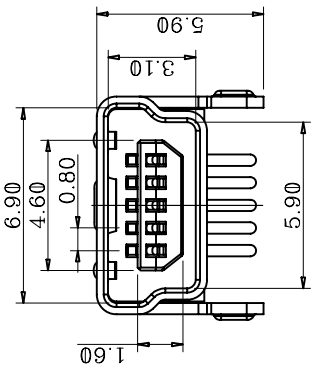
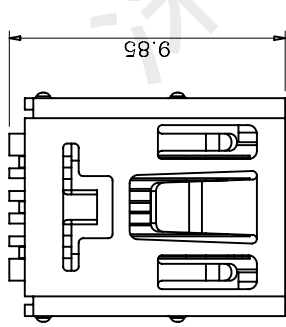
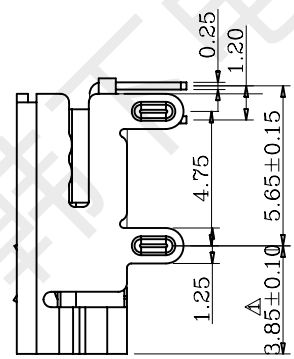
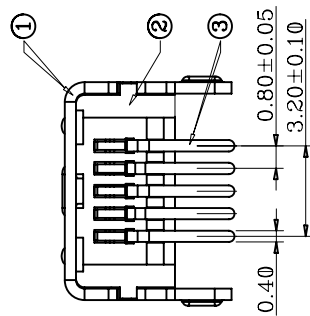


7	REV	ECN NO.
8		



Recommended PCB Layout



Specification:

- 1 Current rating:1.0A AC/DC
- 2 Voltage rating:50V AC/DC
- 3 Contact resistance:50m milliohms max
- 4 Insulation resistance:100 Mega ohms min
- 5 Withstanding voltage:500V AC/minute
- 6 Temperature range:-25°C to +80°C

③	CONTACT	5	COPPER ALLOY	GOLD PLATED OVER NICKEL
②	HOUSING	1	HIGHT TEMP. PLASTIC	UL94V-0
①	SHELL	1	BRASS	GOLD PLATING T=0.40
ITEM	PART NAME	Q'TY/PCS	MATERIALS	NOTE

5	DRAWING:		GENERAL TOLERANCE			HX MINI 5P 90° 4J PART NO: DRAWING NO:P1103F05D-B2Q1-T1D3B2-01
4	黄彬		.X: =±0.2 .X°: =±2° .XX: =±0.10 .XX°: =±1° .XXX: =±0.05 .XXX°: =±0.5°			
3	CHECKED:		UNIT: MM		SCALE: 1/1	REV: 1.1
2	张伟		SHEET: 1/1		APPROVAL:	SIZE: A4
1	罗小春		APPROVAL		DESCRIPTION	
NO.	DATE	DESCRIPTION	APPROVAL			

深圳市韩下电子有限公司



DESCRIPTION:

HX MINI 5P 90° 4J

PART NO:

DRAWING NO:P1103F05D-B2Q1-T1D3B2-01



深圳市韩下电子有限公司

Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-33819206 Fax: 0755-27597491

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 Customer:

产品名称 Project:

USB

规格型号 Part No:

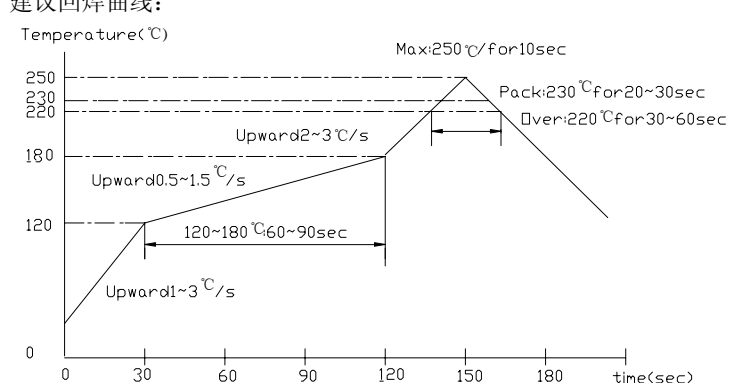
HX MINI 5P 90° 4J

贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	

1. 物料明细:			
1.1. 塑胶部分: LCP UL94V-0			
1.2. 接触端子部分: C5191, 镍底, 接触部位镀金 1 μ "			
1.3. 外壳部分: C2680, 外壳镀镍底 50 μ " , 镀锡 80 μ			
2. 工作条件:			
2.1. 工作电流: 1Ampere			
2.2. 使用温度: -30 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C			
3. 电气性能部分			
序号	测试项目	规格和标准	测试方法及参考标准
3.1	接触阻抗	50m Ω MAX	以低功率电流测试产品接触部位阻抗值 参考: EIA 364-23A
3.2	绝缘阻抗	100M Ω MIN 100V DC	测试相邻接触脚位之间塑胶阻抗值 参考: EIA 364-21A
3.3	耐压测试	500V AC 1分钟 0.5mA	以 0.5mA 的电流测试接触脚位之间塑胶耐高压 1 分钟 参考: EIA 364-20A
4. 机械性能部分			
4.1	插入力	3.57kgf MAX	与线端匹配时, 线端以 25mm/分速度插入时的力 参考: EIA 364-13A
4.2	拔出力	1.02kgf MIN	与线端匹配时, 线端以 25mm/分速度拔出时的力 参考: EIA 364-13A
4.3	端子单PIN保持力	0.5 kgf MIN	接触 PIN 以 25mm/分速度从塑胶中退出来的力
4.4	寿命测试	1. 产品外观无明显损伤 2. 插入力: 3.0kgf MAX 拔出力: 0.7~1.8 kgf	以每小时 600 次匀速插拔产品 3000 次 参考: EIA 364-09A
4.5	振动测试	10 ⁻⁶ 秒	以每分钟频率由 10HZ 至 55HZ, 再回到 10HZ 为一循环, 连续测试 X/Y/Z 三个方向各 2 小时。 振幅为 1.5mm 参考: EIA 364-28A
5. 环境性能部分			
5.1	沾锡性	吃锡面积达 95%以上	产品焊接区于温度为 235 \pm 5 $^{\circ}$ C锡炉中浸泡 5 \pm 0.5 秒 参考: MIL STD-202F
5.2	耐高温	1. 外观无明显损伤 2. 接触阻抗 100m Ω MAX 3. 绝缘阻抗 100M Ω MIN	将产品置于 85 $^{\circ}$ C的高温炉中 96 小时后, 再于常温中置放 3 小时后观察。 参考: MIL STD-1344A
5.3	低温性	1. 外观无明显损伤 2. 接触阻抗 100m Ω MAX 3. 绝缘阻抗 100M Ω MIN	将产品置于-40 $^{\circ}$ C的低温炉中 96 小时后, 再于常温中置放 3 小时后观察。 参考: MIL STD-1344A
5.4	耐湿性	1. 外观无明显损伤 2. 接触阻抗 100m Ω MAX 3. 绝缘阻抗 100M Ω MIN	将产品置于温度为 40 \pm 2 $^{\circ}$ C, 湿度为 90~95RH 环境中, 120 小时后观察。 参考: EIA 364-31A
5.5	耐腐蚀性	1. 外观无明显腐蚀 2. 接触阻抗 50m Ω MAX	将产品置放于盐水浓度为 5%, 温度 35 \pm 2 $^{\circ}$ C的盐雾箱中连续喷雾 12 小时, 于常温放置 1 小时后观察产品。 参考: EIA 364-26A
5.6	耐焊接性	1. 外观无明显变色、起泡; 2. 焊脚吃锡平滑	建议回焊曲线:  <p>The graph shows a reflow soldering temperature profile. The y-axis is Temperature (°C) from 0 to 250. The x-axis is time (sec) from 0 to 180. The profile starts at 0°C, rises at 1~3°C/s to 120°C (120~180°C for 60~90sec), then rises at 0.5~1.5°C/s to 180°C, then rises at 2~3°C/s to 230°C (Pack: 230°C for 20~30sec, Over: 220°C for 30~60sec), peaks at 250°C (Max: 250°C/For 10sec), and finally cools down.</p>